

材料科学与工程学院2026年校内转专业拟接收学生名单公示

序号	转专业方式	转入专业	姓名	学号	综合成绩	测试得分	排名
1	校内插班	电子封装技术	孙鑫	051125228	91.64	95	1
2	校内插班	电子封装技术	孙南雅	041425207	90.2	93	2
3	校内插班	电子封装技术	梁雅菲	041525209	89.6	92	3
4	校内插班	电子封装技术	牛斐硕	058125158	89.44	91	4
5	校内插班	电子封装技术	王崇鉴	058125101	88.44	90	5
6	校内插班	材料科学与工程	房瑾琦	041425312	84.44	85	1
7	校内插班	材料科学与工程	周静雯	031325203	84.2	85	2
8	校内插班	材料科学与工程	戴一一	091825207	84.16	85	3
9	校内插班	材料科学与工程	黄宗雨	091325229	81.72	80	4
10	校内插班	材料科学与工程	黄舒涵	091325108	80.08	80	5
11	校内插班	材料科学与工程	王晗	168225131	77.4	75	6
12	校内插班	材料科学与工程	何官洪	091325311	74.76	70	7
13	校内插班	材料成型及控制工程	严焯力	168125221	90.36	98	1
14	校内插班	材料成型及控制工程	丁鸿宇	091125228	86.36	96	2
15	校内插班	焊接技术与工程	李嘉沐	031325220	92.2	99	1
16	平台内	电子封装技术	陈雨悦	058124038	91	94	1
17	平台内	电子封装技术	李明凯	058124012	88.96	91	2